

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



NSING TECHNOLOGIES INC.

國民技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2701)

海外監管公告

2025年年度報告摘要

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列國民技術股份有限公司(「本公司」)於深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn/>)及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)所發佈之《2025年年度報告摘要》，僅供參閱。

承董事會命
國民技術股份有限公司
董事長兼執行董事
孫迎彤先生

中國深圳，2026年3月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括(i)執行董事孫迎彤先生、闕玉倫先生及葉艷桃女士；(ii)非執行董事周斌先生；及(iii)獨立非執行董事陳衛武先生、郝丹女士及吉杏丹女士。

证券代码：300077

证券简称：国民技术

公告编号：2026-021

国民技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	国民技术（A 股） 國民技術（H 股）	股票代码	300077（A 股） 2701（H 股）
股票上市交易所	深圳证券交易所及香港联合交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶艳桃	欧弘妍	

办公地址	深圳市南山区高新北区宝深路 109 号国民技术大厦 21 层	深圳市南山区高新北区宝深路 109 号国民技术大厦 21 层
传真	0755-86916692	0755-86916692
电话	0755-86916692	0755-86916692
电子信箱	investors@nationstech.com	investors@nationstech.com

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司从事的主要业务涵盖集成电路领域及新能源负极材料两个领域。

（一）集成电路领域

1、公司所处细分行业及主要业务

公司是集成电路设计企业，主要从事自主技术、自主品牌的集成电路芯片研发设计及销售，并提供相应的系统解决方案和售后的技术支持服务。

公司致力于为各类智能终端提供高安全性、高可靠性、高集成度的控制芯片与系统解决方案。凭借行业领先的软硬件安全架构、前沿的异构集成方案以及灵活的兼容适配能力，在消费电子、工业控制和数字能源、智慧家居、汽车电子与医疗电子多个关键领域实现了产品的广泛应用，成功构建了多元化场景覆盖的产品矩阵。

2、经营模式

公司采用常规和灵活的 Fabless 轻资产经营模式，从事集成电路产品的研发设计和销售，将晶圆制造、封装测试业务外包给专门的晶圆制造及封装测试厂商。该经营模式有利于公司集中优势资源用于集成电路产品研发与设计环节，在完成集成电路全流程的设计工作后，将自有产权的集成电路版图授权晶圆制造厂商进行生产制造，由晶圆制造厂商按照版图数据生产出晶圆后，再交由封装、测试厂商完成封装、测试环节。公司取得集成电路芯片成品后，启动对外销售，部分芯片产品应市场需求，委托外协厂商加工成多芯片模组（SIP），对外销售。根据行业、产品及市场需求情况，公司采取直销和渠道销售相结合的销售推广模式开展主要业务经营。

3、主要产品、下游应用领域及应用示例

公司围绕 SoC、信息安全、电源管理、射频四大核心领域，打造了通用 MCU、高等级安全芯片、电源管理 BMS 芯片、无线射频芯片四大产品阵列，下游应用主要涵盖消费电子、工业控制及数字能源、智能家居、汽车电子及医疗电子。除上述五大

领域外，公司在人工智能、机器人、新能源、低空经济等新兴战略性领域进行布局。

(1) 通用 MCU 芯片：作为智能终端的核心控制器，核心功能为接收、处理各类数据并控制设备正常运行，是电子设备实现智能化功能的核心部件；广泛应用于数字能源管理（储能设备、逆变器、AI 数据中心电源、充电桩）、智能家居家电（冰箱、空调、智能门锁、LED 照明）、机器人（外骨骼、人形、清洁机器人）、工业控制（伺服驱动器、PLC、编码器）、消费电子（航拍无人机、TWS 耳机）、医疗电子（血氧仪、制氧机、呼吸机）等领域，同时布局汽车电子、智能计量、安防及人工智能、新能源、低空经济等新兴领域。

(2) 高等级安全芯片：专注于数据安全防护，核心功能是对设备中的敏感数据、交易信息进行加密与校验，防范数据泄露、篡改及非法破解风险；主要为金融支付（金融支付、电子银行、移动支付）、物联网安全（可穿戴支付、智能家居、智慧城市、智能仪表）、汽车电子（车联网 V2X、ECU、数字钥匙）、工业控制（变频、伺服系统、电梯控制、PLC）等场景提供防伪认证、固件代码保护及可信计算能力。

(3) BMS 芯片：核心作用是实时监测电池的电压、电流、温度等运行参数，防控电池过充、过放、过温等安全风险，保障电池安全稳定运行并延长使用寿命；已量产产品应用于笔记本电脑、平板电脑、IPC、航拍无人机及消防设备；高可靠性 BMS AFE 芯片已完成开发，2025 年第四季度该款产品已在工业储能 BMS 市场进行客户送样和测试。

(4) 蓝牙无线射频芯片：属于射频芯片的重要品类，核心功能是实现各类电子设备之间的低功耗蓝牙无线连接与数据传输，支持智能设备间的无线联动；广泛应用于工业物联网（物流溯源）、穿戴设备（智能手表）、智能家居（智能门锁）及金融支付（蓝牙 Key）等领域。

4、下一报告期内下游应用领域的宏观需求分析

随着全球智能终端时代的深入发展及 AI 技术在各领域的深度融合落地，下一报告期内集成电路板块核心产品 MCU 的下游各应用领域需求均呈现向好发展态势，整体市场需求具备增长韧性与发展潜力。

消费电子领域，AI 技术推动终端产品向个性化、轻薄化、智能化和高端化升级，可穿戴设备、娱乐设备等产品持续迭代更新，将释放对 MCU 产品的增量需求。工业控制及数字能源领域，工业 4.0 推动智能制造升级提速，高精制造需求增加及有利

产业政策加持，加速智能终端的智能化升级，对 MCU 的实时性、稳定性和环境适应性提出更高要求，中高端 MCU 需求快速增长；数字能源系统规模化落地，储能设备、逆变器、充电站 / 桩等场景对满足严格可靠性和系统安全性要求的集成电路产品需求持续攀升。

汽车电子领域，新能源汽车渗透率不断提升，智能座舱、自动驾驶、BMS、电机控制等系统快速发展，推动单车 MCU 搭载量持续攀升，成为集成电路板块需求增长较快的领域之一，高规格 32 位 MCU 的需求占比持续提升。

医疗电子领域快速采用 AI 驱动的智能终端，各类医疗设备的应用落地，为集成电路产品带来持续的需求增量。

智能家居领域，AIoT 趋势持续扩大智能装置类别并推动产品智能升级，边缘计算及功能集成成为市场拓展的关键力量，智能家电、智能门锁等产品普及度不断提高，带动 MCU 应用场景持续丰富，需求稳步增长。

AI 产业如火如荼的发展，一方面对于传统和成熟产业，带来追求 AI 趋势发展、符合新技术方向的新产品需求，为芯片产品带来持续增量。另一方面，AI 催生新兴行业，如边缘 AI、机器人等产业及其应用。新兴领域雨后春笋般发展，提升了集成电路产品的市场需求天花板，相关场景对边缘智能控制芯片、高性能 MCU 芯片的需求呈现增长态势；同时，AI 产品及 AI 网络，相对于传统互联网与物联网，对于高等级安全鉴证、通信等需求更为刚性，对安全芯片的需求将呈快速发展态势。

综上，下游各领域终端产品智能化、集成化、高端化的发展趋势，持续推升市场对高性能、高集成度、高安全性、低功耗集成电路产品的需求，推动板块需求结构不断优化，为行业发展提供持续的市场支撑。

5、公司所处行业市场竞争格局情况

国际大商凭借多年在资金、技术、客户资源、品牌、应用生态等方面的积累，形成了长时间的领先优势。这些年，集成电路产业国产化取得了突飞猛进的进展，但总体而言，目前我国集成电路设计、晶圆制造的综合水平与国际先进水平尚存差距。集成电路设计领域，国际厂商在中高端芯片市场占据主导地位，国产厂商在市场处于相对中低端领域的局面尚未完全改变。

MCU 领域，从全球市场来看，主要供应商仍然以国际厂商为主，行业集中度较高，恩智浦、微芯、瑞萨、意法半导体、英飞凌、德州仪器等厂商占据主导地位，行

业头部集中效应显著，国内厂商市场占有率不高且主要处于中低端产品市场。根据 Yole 统计的数据，2024 年全球 MCU 市场中前五大厂商占 75% 的市场份额，前六大厂商，82% 市场份额，且均为国际厂商。相对于全球 MCU 市场而言，国内 MCU 市场较为分散、竞争者数量较多，且主要市场份额仍被国际厂商所占据，同时国际厂商得益于多年的技术积累，中高端产品系列布局完善、品类齐全。尽管如此，近几年国内 MCU 厂商在产品性能、集成度、稳定性、配套开发生态等各方面已取得较好发展，在消费电子等中低端市场已经具备较强竞争力，国内 MCU 厂商也由原先以消费电子为主，积极加强向高壁垒、高毛利的工业控制、汽车电子等中高端领域布局拓展，并且已取得了一定的成绩。在智能电表、白色家电、可穿戴设备等细分领域已实现较高市场渗透率。同时，国内企业凭借性价比、产业链配套、开发周期及服务灵活性等优势，逐步提升在全球产业中的竞争力和市场份额，本土替代趋势显著。

总体来说，随着国内 MCU 厂商的设计能力不断提升，产品系列矩阵日趋完善以及终端客户对于供应链自主可控需求的不断增长，叠加边缘 AI、机器人、新能源、低空经济等新兴领域带来的市场需求增量，国内 MCU 厂商未来市场发展具备充足的增长支撑。

6、发展战略及经营计划

(1) 聚焦 AI 与边缘计算、机器人、工业控制等战略赛道，强化 SoC、MCU、异构计算战略方向，进一步实现芯片产品覆盖新宽度、新深度。

公司秉持“深耕主赛道、突破新领域”的场景拓展战略，正在加速推进 AI、机器人、工业控制、车规电子、智算中心及低空经济等新兴垂直场景的芯片产品布局，目标是在 AI 背景下的高增长、高技术密度的核心场景中，实现战略性领域纵深发展，构建长期竞争优势。通过运用 SoC、MCU、异构计算研发能力，实现符合 AI 背景下的产业新需求的产品。。

通过聚焦 AI 及边缘计算、机器人、工业控制、车规电子、智算中心、低空经济等关键垂直领域，公司将持续推动公司产品的深度与广度的持续突破，在核心场景中构建差异化技术壁垒与客户价值，实现“从边缘智能到能源系统”的全栈式嵌入式控制能力布局，助力企业实现从“应用适配”向“场景引领”的升级跨越。

(2) 重点发展尖端 MCU 产品以及面向新兴场景的周边产品

公司将持续推进“以尖端 MCU 为主导、多种新兴场景全面覆盖”的产品研发战

略，聚焦边缘 AI、数字电源管理、工业网络通信、与车载信息安全等新兴场景，构建具备技术突破与市场穿透力的产品体系。

在“应用适配”向“场景引领”的战略转型下，公司也将围绕智能家居、储能系统、光伏电源管理、医疗可穿戴等新兴场景，持续拓展其他高性能芯片产品，强化规模优势。依托公司在模拟电路、低功耗控制、安全性架构等领域的技术积累，进一步实现核心模块的复用与组合式创新，在边缘计算、电源控制、无线通信等方向构建快速响应的产品迭代体系，推动产品垂直突破和横向延展的全面升级。

（3）持续激发创新要素，保持和引领技术先进

公司始终坚持自主研发驱动公司成长、系统推进核心技术升级的技术创新战略。面向边缘 AI、数字电源管理、工业网络通信、与车载信息安全等关键领域的发展趋势，公司聚焦四大核心技术方向—高集成与先进封装技术、更低功耗的集成电路设计、多核异构架构以及边缘智能与模型优化，全面构建多元化、高性能的芯片产品平台，为复杂终端应用提供持续进化的技术支撑。公司将重点围绕高集成与先进封装技术、更低功耗的集成电路设计、多核异构架构、边缘智能与模型优化四个方向持续加大研发投入与成果落地。

通过以上技术方向的战略性推进，公司将持续构筑技术领先壁垒，打造覆盖传统及新兴应用场景的产品矩阵，推动公司在全球智能控制芯片领域实现从国产替代迈向高端引领的转型跨越。

（4）适度加强基础型 MCU 产品投入，较大幅度提升基础市场的市占率

当前市场规模较大的基础型 MCU 市场竞争极为激烈。公司将适度加强基础型 MCU 产品的迭代速度与市场拓展力度，不断提升产品性价比，稳步提升在消费电子、智能家居、白色家电等主流应用领域的市场占有率，夯实公司产品规模基础。

公司将依托现有技术积累与供应链协同优势，持续优化该类 MCU 产品的性能与成本结构，在保证产品可靠性与兼容性的前提下，构建更具市场竞争力的产品矩阵。同时，公司将通过自主研发团队建设与引导外部资源相结合的方式，探索通过资源整合方式，快速提升该类产品供给能力与市场覆盖范围，完善多层次、全覆盖的产品布局。

（5）吸纳全球优秀人才，有选择地探索收购机会

公司始终将人才视为推动技术进步和企业持续成长的根本动力，高度重视顶尖技术人才的引进与研发梯队的系统建设。未来，公司将进一步完善具备吸引力的激励机

制，强化面向中长期发展的组织文化与创新氛围，持续推动组织效能提升。依托新加坡、日本、美国等海外研发中心，公司不断健全面向全球的人才招聘与培养体系，吸引具备国际视野与产业经验的高端技术人才，构建开放、高效、多元融合的人才生态，夯实全球化业务发展的团队基础。

在此基础上，公司也将有选择地探索对外并购机会，作为实现外生式增长的战略补充方向。未来将重点关注与公司现有产品体系高度协同的优质企业，以实现产业链的垂直整合或产品能力的横向扩展。

（二）新能源负极材料领域

1、行业发展状况

2025 年锂离子电池市场继续保持增长态势，据高工产研锂电研究所（GGII）初步调研数据显示，2025 年中国锂电池出货量 1,875GWh，同比增长 53%。细分领域来看，动力电池板块出货 1.1TWh，同比增长 41%，储能板块出货 630GWh，同比增长 85%。2025 年中国动力电池出货已超过 1TWh，主要受国内新能源汽车及海外动力市场需求增长带动。

2025 年国内锂电池负极材料行业同步呈现增长趋势，根据 GGII 数据，2025 年中国负极材料行业延续高增长态势，全年出货量达 290 万吨，同比增长 39%。从出货企业来看，行业格局显著分化，头部企业产销两旺，中小企业代加工成为常态，部分头部企业一体化代加工比例已超 30%。展望 2026 年，GGII 预计行业仍将保持高增长态势，全年出货量有望超 370 万吨，同比增长 28%以上。

从产品结构来看，人造石墨负极凭借性能适配性与供应链稳定性，持续巩固主导地位，全年人造石墨出货量达 267 万吨，同比增长 49%，占负极材料总出货量的 92.7%；天然石墨则延续下滑态势，全年出货量 21 万吨，同比下降 18.8%，占比不足 8%，主要受海外电池客户加速切换人造石墨、国内应用场景持续萎缩影响，仅在少量动力及数码市场留存应用。

2、报告期内主要业务及产品

目前，新能源负极材料领域业务由控股子公司内蒙古斯诺承担，其主要从事锂离子电池负极材料研发、生产和销售，以及石墨化加工服务。负极材料主要应用于新能源汽车动力电池、3C 数码和储能等锂电池领域；石墨化加工工艺是锂离子电池负极材

料生产过程中的核心工艺环节之一。报告期内石墨化加工除满足内部需求外，也为行业其他用户提供部分石墨化加工服务。

3、经营模式

(1) 采购模式。内蒙古斯诺采购的原材料主料为焦类产品、石墨，辅料为沥青，为保障原材料的稳定供应，同时降低采购成本，采用“按需采购”的模式。

(2) 生产模式。内蒙古斯诺实行“自主生产”模式，结合各类型产品的销售情况、原材料和成品库存量，制定生产计划。石墨化加工主要配套自身负极材料石墨化加工需求，在满足自身需求的基础上剩余产能可对外提供加工服务。

(3) 销售模式。内蒙古斯诺以直销为主，通过多种渠道积极响应行业内客户需求，加快自身技术和产品的升级速度。

4、报告期内行业竞争情况及趋势

锂电池负极材料市场近年来持续保持较高速度的增长，属于较典型的重资产行业，进入门槛较高，且依赖优质矿产资源原材料的开采与制成品的再加工，因此呈现头部集中、中尾部分散的竞争格局。从市场集中度来看，2025 年行业集中度进一步提升，中国市场表现更为显著，2025 年上半年人造石墨负极材料领域前五家企业出货量集中度已达 70%左右。叠加锂电池等下游行业的快速增长，和中国企业在上游资源的全球积极扩展，中国在全球的负极材料市占率保持高位，其余主要为韩国、日本等国家。国内负极材料的主要供应商有贝特瑞、杉杉股份、璞泰来、中科星城、东莞凯金、尚太科技、翔丰华等，国外负极材料的主要供应商有日立化成、浦项未来及三菱化学等。

根据高工产研锂电研究所（GGII）预测，2026 年中国锂电池总出货量将同比增长超 25%至 2.3TWh 以上，其中储能锂电池出货量突破 850GWh，增速有望超 35%；动力电池（含乘用车、商用车用锂电池）出货量将超 1.3TWh，增速超 20%，储能市场的绝对增量有望首次超越动力电池。

全球新能源产业持续扩张，电动汽车、储能产品、两轮电动车、消费电子等终端应用对电池性能提出更严格要求，推动锂电池负极材料向高能量密度、快充能力与长循环寿命方向快速演进。在人造石墨成为主流方案的基础上，硅碳、硬碳等方案也加速推进产业化，形成多元技术路径共存格局。新型储能场景的广泛拓展，也对锂电池负极材料的性能稳定性、成组一致性与成本效率提出更高标准。

然而，受前期新能源汽车和储能市场高速增长预期驱动，行业经历了大规模产能

扩张，包括头部企业扩产和跨界资本涌入，导致 2023-2024 年产能集中释放，市场供给短期内快速增加，形成阶段性产能过剩局面。在市场调整过程中也显现出积极变化，一方面，下游需求逐步回暖，产能扩张明显减速；另一方面，工信部《锂离子电池行业规范条件（2024 年修订版）》的出台，推动行业向高效、低碳方向升级，加速落后产能出清。高工产业研究院（GGII）认为，2025 年负极材料价格虽然短期涨幅仍受市场因素制约，但整体已呈现触底反弹的良好态势，为行业复苏奠定了基础。从 2025 年市场情况来看，2025 年一季度负极用焦价格环比上涨超 40%，带动负极材料成本上升，二季度原材料价格虽有所下滑，但负极材料报价整体保持稳定；下半年随着下游需求持续旺盛，市场呈现供需紧平衡态势，叠加原材料及外协加工价格温和上涨，负极材料价格具备一定上涨动力。

5、发展战略及经营计划

在行业竞争持续加剧的背景下，公司将进一步做好客户的品质保障和产品交付与服务，稳固既定市场，努力争取更高份额；持续加大对潜在客户的资源投入，加快推动潜在客户的导入及量产工作。同时，把“降本增效、提质进位”作为经营目标，持续改进工艺提高生产效率、寻求与上游供应商的战略合作以降低产品成本，探索更有效的成本控制方法；自有产能进一步聚焦高参数、高品质的中高端产品；继续提高新能源负极材料和石墨化工艺的研发能力，积极采用新工艺、开发新产品，丰富产品线。在巩固人造石墨主力产品技术优势的基础上，公司正积极推进硅碳负极及硬碳等多元材料体系的研发与中试验证，力争在高比能、长循环、快充与低温性能等关键性能指标上实现突破，并逐步构建覆盖乘用车、轻型车、储能与消费电池的全应用场景负极材料产品体系。未来，公司将加快推进新一代材料的产品化与客户导入节奏，推动前沿技术从实验室向大规模产业化转化。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末 增减	2023 年末
资产总额（元）	3,570,527,499.26	3,712,938,142.18	-3.84%	3,802,581,431.86

归属于上市公司股东的净资产（元）	919,981,696.47	989,336,343.25	-7.01%	1,171,135,614.15
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入（元）	1,360,265,565.10	1,167,550,263.68	16.51%	1,036,752,756.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	-115,418,159.63	-235,342,415.12	50.96%	-571,523,582.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-138,600,860.68	-195,842,376.58	29.23%	-500,677,155.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	674,624.83	-121,333,477.09	100.56%	-122,356,616.02
基本每股收益（元/股）	-0.20	-0.40	50.00%	-1.00
稀释每股收益（元/股）	-0.20	-0.40	50.00%	-0.99
加权平均净资产收益率	-13.05%	-22.56%	9.51%	-41.99%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	304,044,524.46	327,844,675.81	326,425,846.48	401,950,518.35
归属于上市公司股东的净利润	-21,375,831.47	-15,406,066.43	-36,959,052.04	-41,677,209.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,478,360.93	-17,678,407.19	-44,656,565.41	-50,787,527.15
经营活动产生的现金流量净额	-83,967,539.77	31,668,663.47	-126,277,713.54	179,251,214.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	126,805	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	124,353	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股	报告期末	报告期内	持有有限	持有无限	质押、标记或		

		比例 %	持股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	售条件的 股份数量	冻结情况	
							股份 状态	数量
孙迎彤	境内自然人	2.65	15,453,300	-514,1100	15,445,800	7,500	质押	10,660,000
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.92	5,350,144	541,800	0	9,390,067		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.78	4,573,880	-4,816,187	0	4,808,344		
招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.58	3,378,535	797,735	0	2,800,000		
阎伟	境内自然人	0.50	2,925,600	2,925,600	0	2,580,800		
余运波	境内自然人	0.48	2,800,000	0	0	2,122,600		
聂荣华	境内自然人	0.43	2,499,400	2,499,400	0	2,000,400		
中国工商银行股份有限公司—广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.42	2,424,300	423,900	0	1,560,972		
方发球	境内自然人	0.37	2,140,000	2,140,000	0	969,100		
黄忠林	境内自然人	0.17	1,000,000	1,000,000	0	868,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明			无					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

公司股权分散，无控股股东、实际控制人。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

(一) 主营业务概述

报告期内，公司销售数量同比有较大幅度增加，实现营业收入 136,026.56 万元，较上年同期增长 16.51%。其中集成电路和关键元器件业务销售量较上期增加 14.93%，实现营业收入 66,212.18 万元，同比增长 11%；负极材料业务销售数量较上期增加 13.57%，石墨化加工数量较上年同期增加 23.39%，负极材料类业务（含石墨化加工）实现营业收入 69,814.38 万元，较上年同期增长 22.26%。公司实现归属于上市公司股东的净利润-11,541.82 万元，同比减亏 50.96%，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-13,860.09 万元，同比减亏 29.23%。

业绩变动的主要原因系：

①公司在保持与现有集成电路和关键元器件客户稳固合作的同时，努力调整产品结构与客户结构、积极开拓新客户与新产品市场，公司集成电路关键元器件的销售数量、营业收入和毛利均较上年同期增长。与此同时，公司研发投入仍保持在较高水平，重点聚焦核心市场和应用领域做精做深做广，持续增加高端产品研发，丰富产品系列，提升核心竞争力。

②公司通过巩固存量客户与积极开拓新客户，推动负极材料产品及石墨化代加工销量实现同比增长；同时，负极材料产品销售价格同比上升，且公司通过持续优化产品配方、改进工艺及提高生产效率以降低产品成本。综合影响下，公司负极材料业务的销售收入同比实现较大幅度增长，且综合毛利率同比提高，最终实现了毛利的同比

大幅增长。

③上年同期子公司内蒙古斯诺终止股权激励计划，一次性确认剩余期间股份支付费用 5,865.52 万元。

④资产减值损失较上年同期减少约 5,206.38 万元，主要是存货跌价损失、开发支出减值损失较上年同期减少。

（二）境外发行 H 股上市事项

为优化资本结构、拓宽融资渠道，公司于 2025 年 4 月启动境外发行 H 股并在香港联交所主板上市工作，于 2025 年 6 月向香港联交所递交上市申请，并于 2025 年 12 月完成中国证监会境外发行上市备案。

截至本报告摘要披露日，公司 H 股已完成发行并于 2026 年 3 月 23 日在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（股票代码：02701.HK），成功搭建 A+H 双资本平台。